

H300-DR 专用系列

【导热硅胶垫片】规格书



-产品图-

应用特点：

- 柔软，可压缩性好
- 热阻抗较小
- 表面自带粘性
- 防火性能高
- 低压力下应用
- 很好的电绝缘性能和耐温性能

应用领域推荐：

- 芯片与散热模块之间
- 光电行业
- 网通产品
- 汽车电子
- 可穿戴设备

该系列产品符合RoHS、HSF、卤素管控标准。

储存条件：阴暗处储存

储存温度： $\leq 30^{\circ}\text{C}$

储存湿度： $\leq 70\%$

堆放高度不超过7层，而且总高度不超过1M

保质期：

在储存条件下：二年

不符合储存条件下：六个月

鸿富诚 H300-DR 导热硅胶垫片，是一款柔软性好，超高导热的热界面材料。产品具有良好的电气绝缘特性及耐温性能，并具有高拉伸及高撕裂强度。产品自然粘性和防火性能高，能够很好地填充间隙，实现发热部件到散热部件之间的热传递。产品极具工艺性和使用性，是一种极佳的导热填充材料，被广泛应用于新能源产品中。

产品性能

NO.	参 数	单 位	测试方法
颜 色	白色	---	目视
厚 度	0.5~2	mm	ASTM D 374
硬 度	20~40(± 5)	Shore C	ASTM D 2240
密 度	3.01 \pm 0.5	g/cc	ASTM D 792
拉伸强度	≥ 0.12	Mpa	ASTM D 412
延 伸 率	≥ 100	%	ASTM D 412
压 缩 比	≥ 30 (@50psi)	%	ASTM D 695
使用温度	-50~180	$^{\circ}\text{C}$	IEC 60068-2-14

热学特性

导热系数	3.0 \pm 0.2	W/m \cdot K	ASTM D 5470
热 阻	≤ 0.9 (@20Psi/1mm)	$^{\circ}\text{Cin}^2/\text{W}$	ASTM D 5470

电学特性

击穿电压	≥ 8	KV/mm	ASTM D 149
体积电阻率	$\geq 10^8$	$\Omega\cdot\text{cm}$	ASTM D 257
介电常数	≥ 2	@1MHz	ASTM D 150
介质损耗	≤ 0.1	@1MHz	ASTM D 150

以上数据由鸿富诚实验室提供，该实验室保留最终解释权

